

## SMT Card Edge Verbinder RM 1,27mm - Double Slot Version SMT Card Edge Connectors, 1.27mm Pitch - Double Slot Version

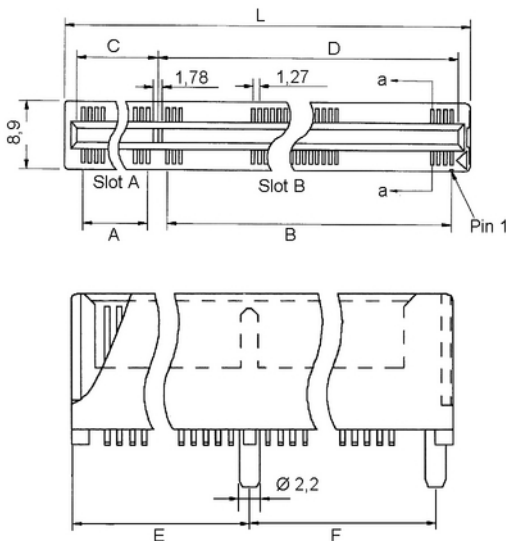
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Im Steckbereich vergoldet / Lötseite verzinkt (über Ni) (andere Veredelungen auf Anfrage)
Contact Surface	Au plated mating area / Sn plated solder area (over Ni) (More plating options on request)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 30mΩ
Contact Resistance	< 30mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	125V <sub>AC</sub> max.
Voltage Rating	125V <sub>AC</sub> max.
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +105°C
Temperature Range	-55°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering
Mechanische Haltbarkeit	> 100 Steckzyklen
Mechanical Durability	> 100 cycles

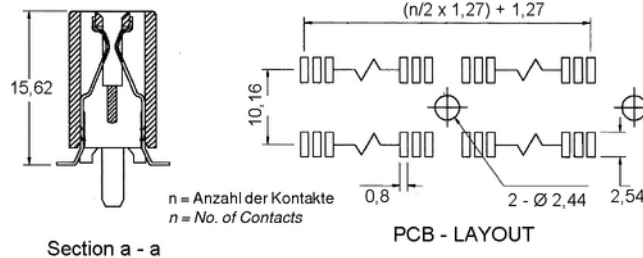


© W+P PRODUCTS

Empfohlene Steckkartendicke:  
1,60mm+/-0,30  
Recommended Thickness of PCB:  
1.60mm+/-0.30



		Dimensions ( mm )							
Contacts		040	050	060	080	100	112	120	182
Slot A / Slot B		22 / 18	22 / 28	22 / 38	22 / 58	22 / 78	22 / 90	22 / 98	84 / 98
A		12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	52,07
B		10,16	16,51	22,86	35,56	48,26	50,88	60,96	60,96
C		15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	55,25
D		13,34	19,69	26,04	38,74	51,44	59,06	64,14	64,14
E		18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	57,66
F		13,97	20,32	26,67	39,37	52,07	59,69	64,77	64,77
L		34,04	40,39	46,74	59,44	72,14	79,76	84,84	124,21



### Series

**1221**

### Contacts\*

**112**

040/050/060/080/100  
112 VESA  
120 PCI 32bit  
182

### Plating

**60**

60 Sel. Au/Sn (Standard)  
Andere Veredelungen auf Anfrage.  
Duplex plating (Standard)  
More plating options on request.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

